

# 5G用電子部品 拡大

## 奥野製薬工業 メッキ薬品工場新設



▲  
新工場では電子部品向けメッキ薬品を手がける(イメージ)

奥野製薬工業(大阪府大阪市中央区、奥野和義社長、06・6203・0721)は2025年にも、放出工場(大阪市鶴見区)内で微細な電子部品向けメッキ薬品を手がける工場を新設する。投資額は約64億円。第5世代通信(5G)の普及を見据え、プリント基板や電子回路向けのメッキ薬品を強化する。

新工場は、既存の表面処理工場を改築する。4階建てで延べ床面積は約7200平方メートル。クリーンルームを充実し、プリント基板や電子回路向けのメッキ薬品を強化する。

5Gや電気自動車(EV)の普及に伴

い、電子部品の小型化・高性能化が進む。同社はプリント基板への微細な配線形成が可能なメッキ薬品などを得意とする。新工場を活

用し、高精度な表面処理ニーズを取り込む。

同社は表面処理分野の売上高が全体の約70%を占める。そのうち電子部品向けは約20%にとどまる。現状、自動車の樹脂部品への加飾など、電子部品以外のメッキ薬品が主力だ。今後5年間で、電子部品向けメッキ薬品が表面処理事業に占める売上高を50%に引き上げる。

新工場を活用し付加価値の高い表面処理技術を磨きつつ、電子部品以外のメッキ薬品と合わせ全体の収益向上を進めていく。